

Białystok, 28.10.2022

### **Rozeznanie rynkowe nr 3**

#### **na zakup usługi w postaci mechanicznego projektu obudowy**

na potrzeby realizacji projektu pod nazwą: „System EOS - innowacja dla biur” o numerze umowy o dofinansowanie nr POPW.01.01.02-20-0058/21-00 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 Osi priorytetowej I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia Działania 1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów Poddziałania 1.1.2 Rozwój startupów w Polsce Wschodniej.

#### **I. Podmiot przeprowadzający rozeznanie rynkowe:**

Sisotech Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Białymstoku adres: ulica Leśna Polana 10, kod pocztowy 15-575 miejscowość Białystok wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000833651

#### **II. Miejsce i termin składania rozeznania :**

Prosimy o przesłanie Państwa cenników (na wzorze będącym Załącznikiem nr 1) na adres mailowy office@sisotech-research.com do dnia 04.11.2022

W tytule wiadomości e-mail podając: „Cennik na zakup **na zakup usługi w postaci mechanicznego projektu obudowy**”.

#### **III. Przedmiot rozeznania rynkowego:**

Wykonanie mechanicznego projektu obudowy, zawierający

Element rozeznania rynkowego	Specyfikacja:
2 koncepcje obudowy dla urządzeń z ekranem i bez ekranu	<ul style="list-style-type: none"><li>- maksymalne wymiary obudowy bez ekranu: 20x10x5cm</li><li>- maksymalne wymiary obudowy z ekranem: 28x20x6cm</li><li>- wizualizacja 3D dwóch koncepcji obudów dla każdego rodzaju</li></ul>
Projekt techniczny obudowy wybranych koncepcji, uwzględniający chłodzenie pasywne	<ul style="list-style-type: none"><li>- maksymalne wymiary obudowy bez ekranu: 20x10x5cm</li><li>- maksymalne wymiary obudowy z ekranem: 28x20x6cm</li><li>- Uwzględnienie otworów na chłodzenie elektroniki</li></ul>

Dobór odpowiednich materiałów	- lista materiałów wraz z wyszczególnionymi parametrami technicznymi (wytrzymałość, temperatura użytkowa, maksymalna temperatura)
Wykonanie modeli 3D	- wykonanie po jednym modelu 3D obudowy dla każdego rodzaju
Przygotowanie dokumentacji technicznej	- Dokumentacja obudowy w PDF, oraz CAD

Ww. przedmiot rozeznania rynkowego, jest realizowany na potrzeby rozwoju systemu EOS, który jest kompleksowym rozwiązaniem do obsługi sal konferencyjnych, biur, a także wspomagającym pracę zdalną. Przeznaczony jest do sterowania urządzeniami multimedialnymi, integracją usług niezbędnych w salach konferencyjnych, oraz udostępnieniem tzw. Wirtualnego Biura dla osób pracujących poza siedzibą firmy.

System EOS składać się będzie z dwóch rodzajów urządzeń: z ekranem, który będzie przypominał tablet, oraz bez ekranu. W obu przypadkach urządzenia te odgrywać będą rolę sterownika innych sprzętów.

Elektronika umieszczona w ww. produktach musi posiadać solidną obudowę, która pozwala na skuteczne pasywne chłodzenie procesora, być wykonana z wytrzymałych materiałów, a także powinna być zaprojektowana w sposób estetyczny zachęcający do kupna..

IV. Osobą upoważnioną do kontaktu w sprawie rozeznania cenowego jest: Pan Wiktor Sienkiewicz tel. 609 023 353 lub e-mail: [office@sisotech-research.com](mailto:office@sisotech-research.com)

Załącznik nr 1 - do **Rozeznania rynkowego nr 3 na zakup usługi w postaci mechanicznego projektu obudowy**

**I. Podmiot przeprowadzający rozeznanie rynkowe:**

Sisotech Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Białymstoku adres: ulica Leśna Polana 10, kod pocztowy 15-575 miejscowość Białystok wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000833651

**II. Dane podmiotu przygotowującego cennik na na zakup i dostawę sprzętu laboratoryjnego**

Nazwa.....  
 Siedziba.....  
 Nr telefonu: .....  
 Dane rejestrowe NIP lub nr KRS.....

Cennik naszej firmy w zakresie przedmiotu rozeznania rynkowego przedstawia się następująco:

Nazwa urządzenia	Specyfikacja dla jednego urządzenia	Cena netto	Cena brutto
2 koncepcje obudowy dla urządzeń z ekranem i bez ekranu	- maksymalne wymiary obudowy bez ekranu: 20x10x5cm - maksymalne wymiary obudowy z ekranem: 28x20x6cm - wizualizacja 3D dwóch koncepcji obudów dla każdego rodzaju		
Projekt techniczny obudowy wybranych koncepcji, uwzględniający chłodzenie pasywne	- maksymalne wymiary obudowy bez ekranu: 20x10x5cm - maksymalne wymiary obudowy z ekranem: 28x20x6cm - Uwzględnienie otworów na chłodzenie elektroniki		
Dobór odpowiednich materiałów	- lista materiałów wraz z wyszczególnionymi parametrami technicznymi (wytrzymałość, temperatura użytkowa, maksymalna temperatura)		
Wykonanie modeli 3D	- wykonanie po jednym modelu 3D obudowy dla każdego rodzaju		
Przygotowanie dokumentacji technicznej	-Dokumentacja obudowy w PDF, oraz CAD		
<b>SUMA</b>			

**III. Doświadczenie podmiotu przygotowującego cennik w projektowaniu obudów do elektroniki:**

.....

Data:

Podpis